



Tagesordnung

- Thema: 58. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“
- Datum: **Mittwoch, 5. Oktober 2016, 10.00 Uhr**
- Ort: Fraunhofer IZM, Berlin, Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin
Gebäude 17, Raum 060ab (neuer Zugang im Erdgeschoss)
- Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Aktuelle IPC-Richtlinien
Herr Ihnenfeld, FED, Berlin
- 3 10:30 Uhr
Bonding Copper Terminals onto DBC Substrates of Power Modules by
Resistance Projection Welding
Herr Waltrich, Fraunhofer IISB, Nürnberg
- 4 11:10 Uhr

Herr, ,
- 5 11:50 Uhr

Herr, ,

- 6 12:30 Uhr
Mittagessen
- 7 13:30 Uhr
Der Einfluss von aktuellen Flussmittelsystemen in Lotpasten auf die Lunker-
Bildung in Lötstellen
Herr Karch, Indium Corporation, Milton Keynes (UK)
- 8 14:10 Uhr
Reinheitszuverlässigkeitsanalyse
Herr Dr. Schweigart, Zestron, Ingolstadt
- 9 14:50 Uhr
Kaffeepause
- 10 15:00 Uhr
Zuverlässige Beschichtung benötigt professionelle Reinigung und Beurteilung
der Beschichtungsqualität mittels Röntgenanalyse
Herr Weber, Elektrotechnik Weber, Zandt
- 11 15:40 Uhr
Zukünftige Zuverlässigkeitsanforderungen an elektronische Systemen
Herr Dr. Middendorf, Fraunhofer IZM, Berlin
- 12 16:20 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr